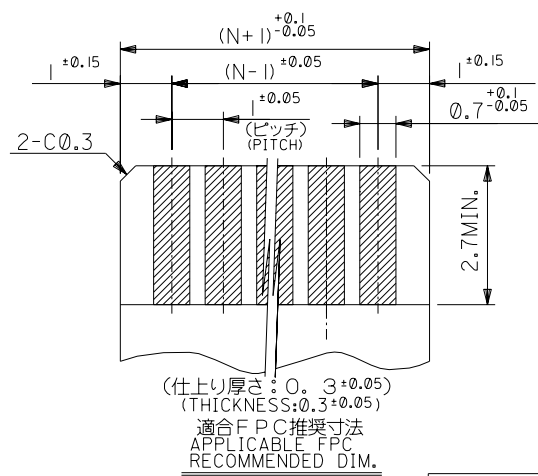


FPCのついで：  
打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。  
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。  
接着剤は熱硬化剤を推奨致します。

ABOUT FPC:  
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION :FORM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.  
RECOMMENDED MATERIAL :  
STIFFENER FILM : POLYIMIDE  
BONDING AGENT : THEROSETTING BONDING AGENT



35.3	31.2	52030-3026	30
33.3	29.2	-2826	28
31.3	27.2	-2626	26
29.3	25.2	-2426	24
27.3	23.2	-2226	22
25.3	21.2	-2026	20
23.3	19.2	-1826	18
21.3	17.2	-1626	16
19.3	15.2	-1426	14
17.3	13.2	-1226	12
15.3	11.2	-1026	10
13.3	9.2	-0826	8
11.3	7.2	-0626	6
9.3	5.2	52030-0426	4

- 注記: ① CKT. No. 1を基準に偶数番目のソルダーテール。  
EVEN NUMBER SOLDER TAIL.  
② CKT. No. 1を基準に奇数番目のソルダーテール。  
ODD NUMBER SOLDER TAIL.  
3. 材料:  
MATERIAL:  
ターミナル: リン青銅 ニッケル下地鍍ビスマスメッキ (t=0.32)  
TERMINAL: PHOS-BRO. TIN-BISMUTH OVER NICKEL PLATING (t=0.32)  
ハウジング: 66ナイロン, UL94V-0  
HOUSING: 66NYLON, UL94V-0  
アクチュエーター: ポリエステル, UL94V-0  
ACTUATOR: POLYESTER, UL94V-0  
4. 本製品は52030-\*\*-20の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52030-\*\*-20.

MODEL NO.		52030-**-26		B	A	MATERIAL NO.	種数 CKT.
材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称 1.0 FPC CONN. Z.I.F. (ST.)			
被覆外径 INS. RANGE		—		-LEAD FREE-			
角度 ANGLE	±3°	DRAWN BY '04/03/12 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/12 K.TOJO	DWG. NO.		REV	
30以上 OVER	+0.3	APP'D BY '04/03/12 M.SASAO		SD-52030-016		0	
10以上 OVER 30 UNDER	+0.25	尺度 SCALE					
未満 10 UNDER	+0.2	記号 LTR					
一般公差 GENERAL TOLERANCES		新規作成 RELEASED (J2004-3077)					
		変更内容 REVISION RECORD					
		日付 DATE					